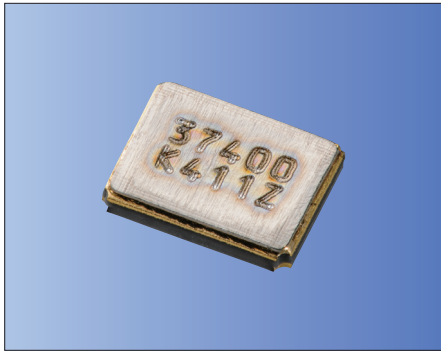


表面贴装型 CX1612DB [消费类电子产品应用]

1.6×1.2mm



RoHS指令对应产品

■特点

- 数字家电·消费类电子产品应用晶体谐振器
- 小型、薄型
32000kHz或更高可对应0.33mm的高度
- 陶瓷封装
- 可对应回流焊

■用途

- 1seg调谐器
- 可穿戴设备
- 真无线耳机

■型号表示方法

CX1612DB 36000 □□ G E J CC
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ①系列名称
③负载容量

- ②频率
④频率容差
(常温偏差)

B0	6 pF	G	±15×10 ⁻⁶
D0	8 pF		

- ⑤工作温度范围以及⑥频率温度特性

EJ	-10 ~ +70°C	±15×10 ⁻⁶
----	-------------	----------------------

- ⑦个别规格(产品目录以CC标示)

包装方式(载带包装 3000/ 20000个卷盘)

■规格

项目	记号	标准规格	单位	备注
频率	f _{nom}	26000 ~ 60000	kHz	
泛音次数	OT	Fundamental	-	
负载容量	CL	8	pF	
频率容差	f _{tol}	±15	×10 ⁻⁶	25°C±3°C
串联电阻	R1	Table 1	ohm	
激励级	DL	Table 2	μW	
工作温度范围	T _{use}	-10 ~ +70	°C	
储存温度范围	T _{stg}	-40 ~ +85	°C	
频率温度特性	f _{tem}	±15	×10 ⁻⁶	对于25°C频率的偏差

以上规格为规格示例, 如需其他规格, 敬请咨询。

■Table1 串联电阻

频率范围	串联电阻
26000 ≤ f _{nom} < 37400kHz	150Ω max.
37400 ≤ f _{nom} < 50000kHz	80Ω max.
50000 ≤ f _{nom} ≤ 60000kHz	50Ω max.

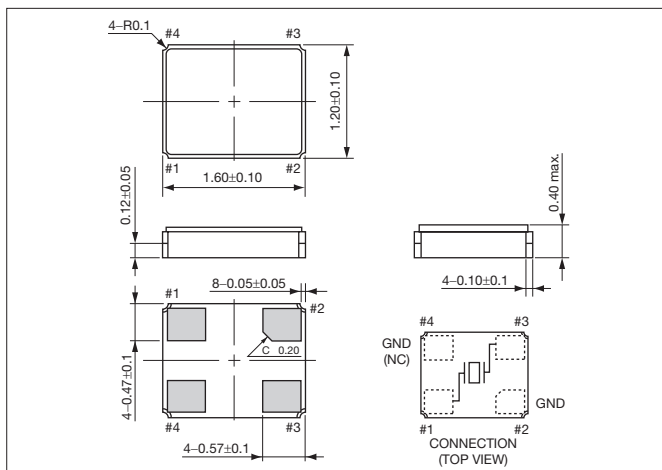
■Table2 激励级

频率范围	激励级
26000 ≤ f _{nom} ≤ 60000kHz	10μW(100μW max.)

晶体谐振器

■外形尺寸

(单位: mm)



■推荐焊盘图案

(单位: mm)

